

概 要

本概要旨在為閣下提供本文件所包含信息的概要。由於此處僅為概要，故並不包含所有可能對閣下具有重要性的信息。決定是否投資[編纂]前，閣下應閱讀本文件全文。

任何投資均有風險，某些與投資於[編纂]有關的特定風險列示在本文件第29頁的「風險因素」。閣下決定是否投資[編纂]前應仔細閱讀該節。

概覽

我們的業務模式

我們是全球領先的純晶圓代工廠，專注於研發及製造專業應用(尤其是嵌入式非易失性存儲器及功率器件)的200mm(或8英吋)晶圓半導體。我們的組合亦包括RFCMOS、模擬及混合信號、CMOS圖像傳感器、PMIC及MEMS等若干其他先進工藝技術。利用我們自身的專有工藝及技術，我們為多元化的客戶製造其設計規格的半導體，客戶包括(i)集成器件製造商；及(ii)系統及無廠半導體公司。考慮到我們工藝的性能、成本及製造產能，我們亦提供設計實施服務，以便對複雜的設計進行優化。

通過華虹NEC及上海宏力，我們擁有悠久的經營歷史，該兩家公司分別於一九九九年及二〇〇三年開始經營，並於二〇一三年合併為華虹宏力。

我們的行業及市場狀況

我們在國內外與純半導體代工企業以及集成器件製造商(將其一部分製造產能用於半導體代工業務)進行競爭。根據IBS的資料，二〇一三年全球代工市場的規模為420億美元，較二〇〇八年的215億美元的年複合增長率為14.3%。預計全球代工市場的收益將於二〇二〇年達到693億美元，二〇一三年至二〇二〇年的年複合增長率為7.4%。

根據IBS的資料，按二〇一三年銷售總額計算，我們是全球第二大純200mm代工半導體公司，而且是世界第六大純晶圓代工廠。

製造技術

我們在1.0 μ m至90nm技術節點上開發並向客戶提供先進的差異化晶圓加工技術組合。尤其是，對需要嵌入式非易失性存儲器加工技術的半導體而言我們是其設計及製造專家。我們相信，我們的嵌入式非易失性存儲器解決方案較我們的競爭對手具備相對更小裸晶尺寸的卓越性能，讓我們成為智能卡及微控制器等多種快速發展的嵌入式非易失性存儲器應用的首選代工半導體公司。我們在功率器件技術方面亦擁有強大的能力，且擁有一個專門製造功率器件產品的製造廠。透過我們靈活的可定制製造平台，我們有能力支持各種客戶特定需求。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

概 要

按技術平台劃分的銷售

下表為我們於所示期間按技術平台劃分的銷售明細（以絕對金額及佔我們銷售總額的百分比列示）。

	截至十二月三十一日止年度					
	二〇一一年		二〇一二年		二〇一三年	
	千美元	%	千美元	%	千美元	%
嵌入式非易失性存儲器	202,410	33.2	175,378	30.7	203,468	34.8
邏輯及射頻	99,522	16.3	111,155	19.5	119,628	20.5
分立器件	121,468	19.9	125,945	22.0	114,118	19.5
模擬與電源管理	54,597	9.0	56,930	10.0	72,360	12.4
獨立非易失性存儲器	106,774	17.5	83,360	14.6	67,051	11.5
其他 ⁽¹⁾	25,073	4.1	18,712	3.2	8,094	1.3
銷售總額	609,844	100.0	571,480	100.0	584,719	100.0

附註：

(1) 包括高壓產品。

按加工技術節點劃分的銷售收入

我們可提供各種不同技術節點的個性化加工服務組合。下表為我們於所示期間按加工技術節點劃分的銷售明細（以絕對金額及佔我們銷售總額的百分比列示）。

	截至十二月三十一日止年度					
	二〇一一年		二〇一二年		二〇一三年	
	千美元	%	千美元	%	千美元	%
0.13 μ m及以下 ⁽¹⁾	136,465	22.4	158,464	27.7	183,936	31.5
0.15 μ m及0.18 μ m	149,448	24.5	134,657	23.6	150,942	25.8
0.25 μ m	56,734	9.3	20,268	3.5	14,073	2.4
0.35 μ m及以上	267,197	43.8	258,091	45.2	235,768	40.3
銷售總額	609,844	100.0	571,480	100.0	584,719	100.0

附註：

(1) 包括0.13 μ m及0.11 μ m。

概 要

製造設施

通過我們位於上海的三家晶圓廠，我們目前的200mm晶圓加工能力在中國名列前茅，截至二〇一四年四月三十日的200mm晶圓加工總產能約為每月124,000片。

下表列示各晶圓廠在歷史記錄期內的估算月產能、實際平均月產量及產能利用率。

	截至十二月三十一日		
	二〇一一年	二〇一二年	二〇一三年
	(以每月千片200mm晶圓計，百分比除外)		
<u>估計月產能</u>			
一廠	50	50	50
二廠	32	34	34
三廠	37	38	40
總估計月產能	119	122	124
截至該日止年度平均月產量 (實際)	99	99	104
產能利用率 ⁽¹⁾	83%	81%	84%

附註：

(1) 產能利用率按平均月產量除以總估計月產能計算。

考慮發展策略及盈利增長，我們擬於二〇一六年年年底將200mm晶圓加工產能增至每月約164,000片晶圓，以應對我們客戶不斷增加的訂單需求。

我們的客戶

我們服務多元化的客戶群，其中包括部分世界領先的半導體公司，如Cypress、Microchip及ON Semiconductor。我們的客戶主要分為兩大類：(i)集成器件製造商；及(ii)系統及無廠公司。根據IBS的資料，於歷史記錄期，我們為全球20個國家逾600名客戶提供服務，包括前30家半導體公司(按二〇一三年估計銷售計)中11家。

我們二〇一三年的銷售收入中約50%來自立足中國的半導體公司，例如華大、國民技術及同方微電子。我們擬繼續與我們的全球客戶緊密合作以及利用我們的規模及技術領先地位進一步應對快速發展的中國半導體行業所湧現的機遇。

概 要

產品及應用

我們生產的半導體可被植入不同市場(包括電子消費品、通訊、計算機、工業及汽車)的各種產品中。下表為所示期間我們按終端市場分部列示的銷售明細。

	截至十二月三十一日止年度					
	二〇一一年		二〇一二年		二〇一三年	
	千美元	%	千美元	%	千美元	%
終端市場分部						
電子消費品	226,965	37.2	235,189	41.2	265,887	45.5
通信	174,055	28.5	177,008	31.0	173,970	29.8
計算機	143,618	23.5	111,879	19.6	87,093	14.9
工業及汽車	65,206	10.8	47,404	8.2	57,769	9.8
總計	<u>609,844</u>	<u>100.0</u>	<u>571,480</u>	<u>100.0</u>	<u>584,719</u>	<u>100.0</u>

我們的競爭優勢

我們的競爭優勢包括：

- 專注於先進、差異化技術的領先200mm純晶圓代工廠；
- 關係持久的多樣化全球客戶群；
- 規模龐大且快速成長的中國半導體市場中的成熟企業；
- 靈活的可訂制製造平台；
- 具競爭力的成本架構以及注重股東價值；及
- 由資深高級管理層領導的優秀員工。

概 要

我們的業務策略

為發展業務及為股東創造價值，我們會實施以下主要策略：

- 繼續改善產品組合，把握高利潤率及高增長率的機會；
- 不斷投資於我們的主要競爭優勢之一差異化先進技術的研發；
- 繼續實現合併協同效益；
- 追求策略及盈利上的產能擴張；及
- 強化與主要客戶的合作並繼續提供優質服務。

合併財務資料概要

下文為我們於二〇一一年、二〇一二年及二〇一三年十二月三十一日及截至該等日期止年度的合併財務資料概要，摘自本文件附錄一所載會計師報告。

合併損益表

	截至十二月三十一日止年度		
	二〇一一年	二〇一二年	二〇一三年
	千美元	千美元	千美元
銷售收入	609,844	571,480	584,719
銷售成本	(459,172)	(453,559)	(459,270)
毛利	150,672	117,921	125,449
其他收入及收益	50,998	26,492	30,605
投資物業公平值收入	1,322	944	2,095
銷售及分銷費用	(10,290)	(8,831)	(8,052)
管理費用	(61,327)	(55,097)	(69,043)
其他費用	(5,618)	(448)	(199)
財務費用	(19,168)	(16,928)	(16,479)
分佔一家聯營公司溢利	—	3,619	6,437
稅前溢利	106,589	67,672	70,813
所得稅開支	(10,966)	(7,993)	(8,964)
年內溢利	95,623	59,679	61,849

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

概 要

合併財務狀況表摘要

	截至十二月三十一日		
	二〇一一年	二〇一二年	二〇一三年
	千美元	千美元	千美元
流動資產總值	614,530	526,434	603,786
流動負債總額	392,464	314,283	323,859
流動資產淨值	222,066	212,151	279,927
長期資產總額	1,057,632	1,081,540	1,043,831
長期負債總額	377,425	329,934	267,539
淨資產	902,273	963,757	1,056,219

合併現金流量表摘要

	截至十二月三十一日止年度		
	二〇一一年	二〇一二年	二〇一三年
	千美元	千美元	千美元
經營活動產生的現金淨額	232,379	168,932	184,234
投資活動所用現金淨額	(97,623)	(149,560)	(16,754)
融資活動所用現金淨額	(106,730)	(130,644)	(72,059)
現金及現金等價物增加(減少)淨額	28,026	(111,272)	95,421
年初現金及現金等價物	309,851	329,738	218,170
匯率變動影響淨額	(8,139)	(296)	3,454
年末現金及現金等價物	329,738	218,170	317,045

主要財務比率

下表載列於所示日期及截至該等日期止期間的主要財務比率：

財務比率	公式	截至十二月三十一日/截至十二月三十一日止年度		
		二〇一一年	二〇一二年	二〇一三年
盈利能力比率：				
1. 增長率				
a. 銷售增長率	a. 按年增長	—	(6.3)%	2.3%
b. 淨利潤增長率	b. 按年增長	—	(37.6)%	3.6%
2. 利潤率				
a. 毛利率	a. 毛利/銷售收入 × 100.0%	24.7%	20.6%	21.5%
b. 淨利率	b. 年內溢利/ 銷售收入 × 100.0%	15.7%	10.4%	10.6%
3. 淨資產收益率				
a. 淨資產收益率	a. 年內溢利/平均 淨資產 × 100.0%	11.7%	6.4%	6.1%
b. 總資產報酬率	b. 年內溢利/平均 總資產 × 100.0%	5.8%	3.6%	3.8%

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

概 要

財務比率	公式	截至十二月三十一日／截至十二月三十一日止年度		
		二〇一一年	二〇一二年	二〇一三年
流動比率：				
1. 流動資金比率				
a. 流動比率	a. 流動資產／流動負債	1.6	1.7	1.9
b. 速動比率	b. (流動資產－存貨)／ 流動負債	1.3	1.4	1.6
2. 周轉比率				
a. 存貨周轉天數	a. 平均存貨／ 銷售成本 × 365天	82	82	78
b. 應收款項周轉 天數 (平均 收款期)	b. 平均貿易應收款項／ 收益 × 365天	62	63	66
c. 應付款項周轉 天數 (平均 付款期)	c. 平均應付款項／ 銷售成本 × 365天	48	45	47
資本充足率：				
1. 資本負債比率	(銀行借款及其他借款總額－ 現金及現金等價物以及抵押 存款)／淨資產 (權益) × 100.0%	18.3%	20.6%	4.5%
2. 利息償付比率	息稅前溢利／財務費用	6.6	5.0	5.3

有關我們主要財務比率的進一步詳情，請參閱本文件第209頁「財務資料－主要財務比率」一節。

我們的股權架構

控股股東

緊隨[編纂]完成後，並無計及因超額配股權獲行使而可能發行的股份，華虹集團及上海聯和將於本公司已發行股本中分別擁有約33.89%及20.16%的權益。此外，上海聯和控制華虹集團51.83%的投票權，乃由於其擁有華虹集團的47.08%股權及額外4.75%投票權乃根據儀電控股與上海聯和的投票集團取得。緊隨[編纂]完成後，華虹集團及上海聯和將分別被視為本公司的控股股東。

概 要

近期發展

根據我們摘自本集團截至二〇一四年四月三十日止四個月的未經審核簡明合併中期財務資料報表的我們截至二〇一四年四月三十日止四個月的未經審核財務資料，我們錄得收入總額2.081億美元。二〇一四年二月，我們向上海華力作出最後一期的投資。於最後實際可行日期，我們於上海華力的總股權為17.72%。

[編纂]統計數字

[編纂]： [編纂]

[編纂]架構： [編纂]

超額配股權： 佔根據[編纂]初步提呈的[編纂]數目最多15%

每股[編纂]： [編纂]

	基於每股 [編纂] [編纂]港元 的[編纂]	基於每股 [編纂] [編纂]港元 的[編纂]
[編纂]完成時本公司的市值 ⁽²⁾	[編纂]	[編纂]
[編纂].....	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 本表所有統計數據均假設超額配股權並無獲行使。
- (2) 市值根據[編纂]完成時預期將發行的[編纂]股股份來計算。
- (3) 未經審計備考經調整每股有形資產淨值乃於作出本文件附錄二「未經審計備考財務資料」所述的調整後，基於緊隨[編纂]完成後已發行[編纂]股股份按每股股份[編纂]港元及[編纂]港元的[編纂]計算。

概 要

未來計劃及所得款項用途

下表載列我們將收取的[編纂]估計所得款項淨額（經扣除承銷費用及佣金（假設悉數支付酌情獎勵費）以及我們就[編纂]應付的預計費用）：

	超額配股權 未獲行使 (以美元計)	超額配股權 獲悉數行使 (以美元計)
假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元 (即本文件所述[編纂]範圍的中位數)	[編纂]	[編纂]
假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元 (即本文件所述[編纂]範圍的上限)	[編纂]	[編纂]
假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元 (即本文件所述[編纂]範圍的下限)	[編纂]	[編纂]

假設[編纂]釐定為每股[編纂][編纂]港元（即本文件所述[編纂]範圍的中位數）以及超額配股權未獲行使，我們擬將[編纂]所得款項淨額用於以下用途：

- (i) 所得款項淨額約[編纂]（或[編纂]美元）將用於擴充我們的產能，具體為於設備、工具及設施的投資。有關詳情，請參閱「業務－製造設施及技術－產能及利用率－技術升級及產能擴張計劃」。
- (ii) 所得款項淨額約[編纂]（或[編纂]美元）將用於研發、技術及知識產權投資；及
- (iii) 所得款項淨額餘下約[編纂]（或[編纂]美元）的金額將用於為我們的營運資金提供融資及其他一般公司用途。

若[編纂]定在較估計[編纂]範圍的中位數為高或為低的水平，上述所得款項分配將按比例予以調整。

進一步詳情請參閱本文件第216頁「未來計劃及所得款項用途」一節。請亦參閱本文件第103頁「業務－我們的業務策略」。

概 要

股息政策

於歷史記錄期我們並無宣派任何股息，目前我們亦無意派付二〇一四年股息。[編纂]完成後，我們可能以現金或我們認為合適的其他方式分派股息。請參閱本文件第212頁「財務資料－股息政策」一節。

無重大不利變動

董事確認，自二〇一三年十二月三十一日起直至本文件日期，我們的財務或貿易狀況或前景並無重大不利變動，且自二〇一三年十二月三十一日起直至本文件日期並無會對附錄一「會計師報告」所示資料造成重大影響的事件。

風險因素

我們的營運及[編纂]涉及若干風險，其中許多不在我們控制範圍內。該等風險可分類為：(i)有關我們業務的風險，(ii)有關我們行業的風險，(iii)與在中國經營業務有關的風險，及(iv)與[編纂]及我們的股份有關的風險。我們認為，我們面臨的最重大的風險包括：

- 倘我們無法在我們專注的專業應用方面保持技術領導者地位，或倘我們無法及時應對快速變化的半導體市場動態，我們的競爭力或會下降；
- 倘我們無法有效地管理產能及優化生產設施，我們的競爭力可能被削弱；及
- 倘我們不能持續保持高產能使用率、優化晶圓生產的技術組合及保持生產成品率，我們的利潤率或會大幅下滑。

有關所涉及的所有風險因素的詳細討論，載於本文件第29頁「風險因素」一節。閣下在決定投資[編纂]前應仔細閱讀整個章節。

已產生或將產生的上市開支

截至二〇一一年、二〇一二年及二〇一三年十二月三十一日止三個年度，我們並無產生任何上市費用。我們預期將產生上市費用(不包括承銷佣金)約[編纂]美元，其中[編纂]美元預期將確認為截至二〇一四年十二月三十一日止年度的管理費用，[編纂]美元預期將直接確認為權益減值。董事預期，該等開支不會對我們截至二〇一四年十二月三十一日止年度的財務業績產生重大不利影響。